



## 제 6회 미디어와 기업을 하나로 'E-SUMMIT' 샌프란시스코에서

글 | 김현경 기자 hkkim@semiconnet.co.kr

**캘**리포니아주 샌프란시스코에서는 지난 3월 31일부터 4월 3일까지 4일간 전세계 50여명의 전자 미디어 매체의 기자들과 전세계적인 전자기업들이 한자리에 모이는 'ELECTRONIC-SUMMIT'이 열렸다. 이곳에서 전자산업의 현재와 미래를 조망하는 패널 토론과, 기조연설, 새로운 응용 프로그램 설명, 기업의 신제품 발표 등의 자리가 마련되었다.

올해로 6회를 맞이한 'E-SUMMIT'은 해를 거듭 할 수록, 미디어와 참여 기업들의 관심이 높아지고 있는 국제적인 행사이다.

세계적인 기업의 대표자들의 자신의 기업에 대한 자신감과 신형 기업들의 뜨거운 열정, 기자들의 열띤 토론과 날카로운 질문들이 가득했던 시간들이었다.

특히나 '소비자의 콘텐츠와 미디어'의 주제로 열린 패널 토론에서는 '미래의 멀티미디어 콘텐츠 및 유통'에 대한 의견들을 발표하였다. 패널들은 "지금까지 대부분의 세계에서 어떤 형태의 광대역 및 인터넷 연결, 풍부한 미디어에 대한

수요가 폭등하고 있으며, 이는 즉 우리가 많은 차세대 디지털 장치를 이용해 필요에 따라 액세스할 수 있다. 또한 우리의 모바일 장치를 이용하여 실시간으로 관리, 캡처, 디스플레이, 암호화 및 해독을 할 수 있다. 우리는 언제, 어디서나 그들이 필요 할 때 멀티미디어 콘텐츠를 이용하여 사용할길 원하는 디지털 소비자들의 만족할 줄 모르는 요구를 만나게 될 것이며, 우리의 중점으로 새로운 반도체, 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 탐구할 것이다."라고 의견을 내었다.

이 밖에도 'Mento Graphics', 'Actel', 'XILINX', 'eASIC'와 같은 기업들의 기조연설 시간과 신형기업들의 신선한 아이디어 제품들의 발표와 시연 행사도 함께 진행 되었다.

강력하며 빠른 라우터와 무선 액세스를 이용한 인터넷의 사용은 나날이 성장하는 전자 기술을 통해서만 가능하며 이는 오늘날 우리의 삶과 함께 하고 있다. 이러한 혁신적인 전자산업의 발달은, E-Summit과 같은 자리를 통해 기업들의 경쟁과 성장을 향한 진통, 그리고 이에 관심을 갖고 함께 참여하는 우리들로 인해 가능케 되고 있다.



순간과워를 위해 메탄올을 이용하여 재충전할 수 있다.

MTI의 CEO Peng Limd은 “디지털 카메라는 소비자 리튬 이온전지 시장에서 두 번째로 큰 수익부분을 차지하고 있다.” 또한 “새로운 모델들이 더 많은 고급기능으로 설계 될 것이고 고 해상력 비디오녹음과 재생 배터리 수명과 같은 것이 주요이슈가 될 것이다.”라고 말했다.

오늘날의 DSLR 카메라는 일반소비자들에 의해 구매가 증가하고 있다. 2007년 산업근거에 따르면, 대략 6만 DSLR이 MTI 마이크로로 시제품과 호환성이 있었으며 이 시장은 몇 년 동안 계속해서 성장 할 것으로 예상된다.

일본 도쿄에서 열린 제 4회 국제 수소 연료전 엑스포 2008에서 이 제품은 모비온 마이크 연료전지 기술상을 수상했다.

이 엑스포에서 MTI 마이크로로 부스는 시제품과, 모비온 마이크로 연료 전지를 위한 잠재적인 어플리케이션의 개요를 방문객들에게 전시하였다. MTI 마이크로로 재충전 할 수 있는 모비온 외부파워 팩 충전지들은 핸드폰을 포함한 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 스마트폰 등 최첨단 휴대용 전자제품의 다양한 힘을 제공할 것이다.

게다가, MTI 마이크로는 새로운 임베디드 연료 전지 기능 모델들을 개발하였다. 고객시장에서 모비온 마이크로 연료 전지의 예상되는 가장 중요한 구상 모델의 향후 제품의 방향인 최첨단 스마트폰을 위해 디자인되었다.

최근 임명된 MTI 마이크로의 일본 대표 Yasuo Mohri는 “국제 수소와 연료전지 엑스포는 우리의 전략적인 파트너들이 될 수 있는 잠재적인 많은 모임들이 우리의 시제품을 실물로 선전 할 수 있는 부가적인 기회들을 우리에게 제공할 것이다” 또한 “일본에서 지속적으로 존재하는 한, 우리의 관계는 현지시점에서 이득을 얻게 될 것이며, 그래서 메탄올 연료 전지 기술의 상업화 되는 방향으로 앞서나가는 위치로 굳어지는 동안, MTI 마이크로는 그 지역에서 계속해서 강한 관계로 육성 될 것이다.” 라고 설명했다.

**은세미,**  
명료한 음질을 전달하는 오디오 프로세서  
BelaSigma 300 출시!

은세미사는 이동통신 장비용 차세대 초 저전력 하이파이

## 개최!

### MTI 마이크로, 디지털카메라를 위한 연료전지 시제품 발표

MTI 마이크로로 새로운 모비온 전지 Direct Methanol Fuel Cell(DMFC) 카메라 그립 시제품은 DSLR 카메라를 위한 카메라 배터리 팩 그립과 같은 역할을 한다. 이 시제품은 현존하는 같은 사이즈의 카메라 배터리 팩 그립의 2배 가량의 에너지를 제공한다. 또한, 이 모비온 카메라 그립은 콘센트로부터 재충전 하지 않아도, 사진사가 어디서나 어느 시간이든 카메라를 자유롭게 사용 할 수 있는



오디오 프로세서 BelaSigma 제품군의 신제품을 발표했다. BelaSigma 300은 휴대폰, 차량용 핸즈프리 키트 및 무선 헤드셋 등 이동통신 기기를 겨냥한 제품이다.

BelaSigma 300은 보다 뛰어난 음질의 명료성을 추구하는 통신기기 제조사와 오디오 프로세싱 알고리즘 개발자를 위한 이상적인 솔루션이다. 특허를 받은 독특한 듀얼-코어 구조로 초 저전력 소모를 유지하면서, 잔향 제거와 잡음 감소 등 다양한 최신 오디오 알고리즘을 실현한 것이다. 24비트 개방형 DSP 코어와 높은 가변성을 갖는 신호처리가속엔진을 탑재한 BelaSigma 300은 고정 기능 ASIC 수준의 크기와 전력 소모에도 불구하고, 제너릭 DSP의 유연성을 지니고 있다. 24비트 신호 경로와 결합된 첨단 아날로그 오디오 입력단이 추가 장착되어 최상의 음질을 들려 준다. BelaSigma 300은 통신기기의 전체적인 폼 팩터에 전혀, 또는 거의 영향을 미치지 않으면서 새로운 또는 기존의 디자인에 모두 통합 가능하다.

온세미의 히어링 앤 오디오 솔루션 그룹상무 미셸 드 메이는 "BelaSigma 300은 가장 낮은 전력을 소모하고, 가장 작고 가장 기능적인 오디오 프로세서로 최상의 음질을 제공하는 우리의 전략의 새로운 단계이다."라고 설명했다. 이와

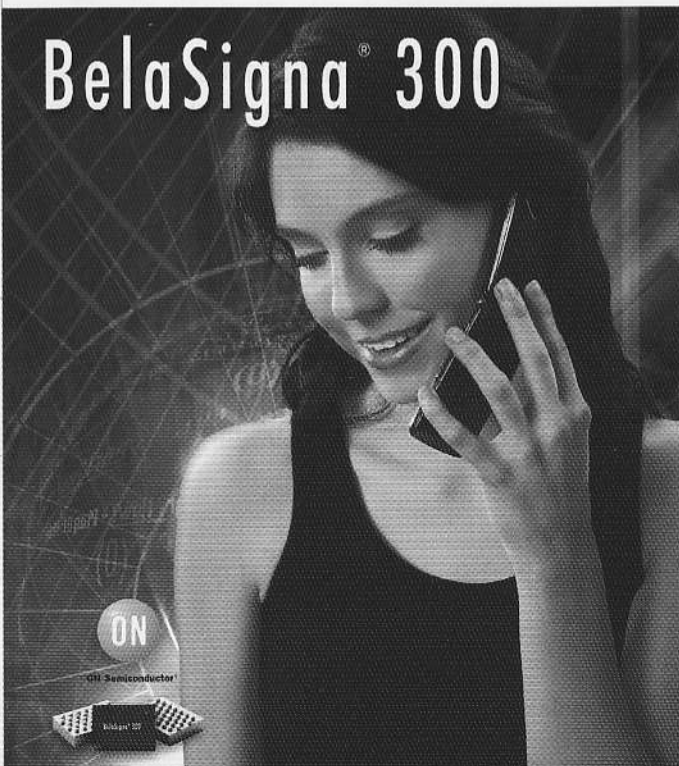
함께 온세미의 오디오 솔루션 팀장인 데이빗 쿼드는 "전반적으로 전력을 적게 소모하는 24비트 데이터패스 구조로 옮겨가는 추세로 인해, 고객들은 보다 많은 신호를 처리할 수 있게 될 것이다. 휴대용 전자기기들의 폼 팩터가 갈수록 줄어들더라도 음질은 꾸준히 향상될 것이다."라고 말했다.



캘리포니아 엘 세군도에 자리한 iSuppli 사의 수석 분석가 조던 셀번은 "모든 휴대용 이동통신 기기에 있어 매우 높은 음질을 추구하는 고객들의 수요 때문에, 확장된 연산 능력을 갖추고도 매우 낮은 전력을 소모하는 오디오 프로세서에 대한 필요성이 날로 커지고 있다. 이러한 추세는 오디오 프로세싱 서비스시스템을 판매하는 회사들에게 향후 매력적인 시장을 제공 할 것이다." 라고 덧붙여 말했다.

BelaSigma 300을 보완하기 위해 온세미에서는 BelaSigma 300 설계에 특별히 디자인된 고급의 full-duplex 잔향제거 알고리즘을 공개했다. 이 알고리즘은 무선 헤드셋 및 핸즈프리 키트에 적용 할 수 있다.


## BelaSigma<sup>®</sup> 300



### 휴대용 음향 기기 트렌드

운전 중 한 손으로 휴대전화 통화를 금지하는 법안은 세계 각국에서 이미 통과되었거나 검토 중에 있으며, 이는 핸즈프리 키트 및 무선 헤드셋 구입에 영향을 미치고 있다. 차량 소음으로 인한 잔향 제거와 잡음 억제의 필요성 때문에 이러한 기기에 탑재되는 오디오 프로세싱 시스템에 대한 요구 수준은 갈수록 높아지고 있다. 휴대전화 이용자들 역시, 주위의 소음 때문에 통화가 어려운 상황을 자주 겪는다. 소비자들은 보다 좋은 음질을 원하고 있으며, 이는 다시 기기 제조사와 시스템 디자이너들로 하여금 휴대용 음향 기기에 보다 진보된 오디오 프로세싱 기능을 통합시킬 것을 요구한다. 또한 이러한 기능은 종종 배터리 수명을 향상시키면서도 더욱 작은 폼 팩터 안에서 구현되어야 한다.

## Tela Innovations, 45nm를 넘어서는 석판술 도전과 제조 어드레싱을 위한 기술과 전략 발표

 45nm를 넘어서는 규격조절 반도체 제조 도전 어드레싱에 초점을 맞추고 있는, 초기단계 기술기업인 Tela Innovations는 on-grid, 일직선, 피상적인 배치 구조의 사용을 위한 기술 비전과 비즈니스 전략을 발표하였다.

이 회사는, IP와 디자인 툴, 프로세스 기술, 디자인 솔루션 제공 계획 전문가 팀에 의해 세워졌다. 이것은 석판술의 최적화된 레이아웃의 라우팅 결과와 종합적으로 다룰 때, 논리, 임베디드 메모리, 아날로그 및 I/O 기능을 사용하기 위해 미리 정의된 물리적 토폴로지의 접근성을 사용한다.

이는 결과적으로 디자이너와 장비공급자 및 제조 업체에게 이익을 가져다 주며, 변동 개선, 성능, 누출 및 번적에 영향을 미치지 않고 기존의 설계 방법론, 장비 세트 또는 프로세스 기술을 지원한다.

지난 3년간 이 솔루션은 꾸준히 성장하였으며, 특히 반도체 과정의 계속되는 규격조절의 방법으로 정체되어 있는 최신 디자인과 석판인쇄술의 접근의 규제에 대해서 이야기 한다. 프로세스 기술이 '서브의 파장' 시대(여기서 프로세스의 크기가 파장보다 빠르게 축소)로 더욱 빠르게 진척되는 것처럼, 디자인 스타일의 변화를 위한 대규모 생산의 증가와 비용의 감소의 필요가 증가하고 있다. 특별히 산업은 상호작용 레이아웃에 대한 어떤 더 많은 제한적인 방향으로 옮겨가는 것을 허용 한다. 그리고 32nm 및 그 보다 작은 관련된 기술을 사용하는 것을 뜻하며, 어드레스를 두 번 노출하고 두 패턴으로 이러한 도전을 한다. 이는 한 개의 마스크가 효율적이고, 두 개의 마스크가 예상대로 나뉘는 패턴이 가능한 디자인 접근 방식이 필요하다.

Tela의 CEO Scott Becker는 "반도체 프로세스의 규격조절의 도전은 물리학적인 어떠한 중요한 일로 인해 기대에 어긋나 버렸다. 그러나 이미 복잡한 디자인 흐름이 프로세스의 상호작용의 추가적인 복잡함이 아니라는 대답이다. 이 해

결책은 디자인 생산성이 10억 트랜지스터 칩을 완전히 이해하는 것을 요구하는 것을 이루기 위하여 IC 디자이너로부터 물리적으로 감추어야 한다. 우리는 석판술 능력의 이해를 시작으로 전례가 없던 어떠한 물리적인 효과의 출현을 다루기 위하여 디자인의 K1 제한을 효과적으로 낮추어 우리의 레이아웃을 능률적으로 활용하는 적극적인 접근방법을 가지고 있다."라고 설명했다.

이 솔루션은 똑바로 된 도구를 사용하고 표준 EDA 흐름 이내에서 작업을 하며, 반도체 제조 공정에서는 마스크를 준비하는 것이다. 우리는 경제적, 기술적으로 효율적인 방법을 계속 규격조절 하는 디자인 스타일의 필요성이 다음 세대에 나타날 것이라는 것을 믿고 있다.



Tela의 솔루션은 규칙적인 패턴으로 구성되어 있으며, 미리 정의된 토폴로지는 휘어지거나 굽어 지지 않은 직선으로 구성되어 있다. 토폴로지는 ASIC/Soc IP의 통사적인 정렬을 만드는데 사용 할 수 있다. (표준전지 라이브러리, 메모리 컴파일러, I/O 전지 등)

디자이너와 제조업자에게 더 많은 임의의 레이아웃 방법론에 의해 유발 되는 예측 할 수 없는 다양성을 줄이고, 도형들 간의 상호 작용 고정 집합을 디자이너와 제조업자에게 접근법을 제공한다. 제조업체가 제공하는 전통적인 디자인 규칙을 지원하고 관계시키는 동안 -하지 말아야 할 것을 디자이너에게 말한다- Tela의 토폴로지는 적극적인 안내로 디자이너가 무엇을 해야 할지 생성하는 일련의 구조를 정기적

으로, 예측 회로를 레이아웃 해준다. 그 결과 로직 블럭이 낮은 K1 석판술을 제한한다.

엔지니어링의 부회장 Nick Yu, Qualcomm은 “우리의 제조업체 파트너에 대한 잘 정의된 상호 작용의 한정되어 현존하는 종합적인 디자인 방법론의 개념은 디자인 프로세서의 능률을 증진 시킬 뿐 아니라, 다양성의 감소를 우리에게 호소한다” 라고 말했다. 또한 “Tela의 접근 방식을 보면 우리의 디자인 목표를 회의하는 동안 디자인 스타일 구조를 제공하는 능력을 보증하고 있다. 그 혁신 결과 우리는 진보된 프로세스 기술들을 위한 시각이 증진되었다” 고 설명했다.

초기의 테스트의 경우 Tela의 솔루션 디자인을 타겟하여 고급프로세서의 제한 누출과 성과가 개선 된 축소 영역에서 입증 되었다. 한 소비자의 테스트 결과 15% 면적 축소 및 45nm 공정을 사용하여 누출 2.5x 감소하였다. 게다가 셀 및 테라 솔루션을 사용하여 만든 결과 블록을 성공적으로 구현 되었으며, 이는 기존의 생산 디자인 플로우 및 도구를 사용한다.

### 인텔 캐피탈, Tela Innovations의 투자자가 되다!

Tela Innovations 는 인텔그룹의 글로벌 투자 권력인 인텔 캐피탈이 이 기업의 새로운 투자자가 되었다고 발표하였다. 인텔 캐피탈의 투자는 현존하는 투자자와 마찬가지로 새로운 아시아기술관리 투자자를 포함하는, 이 회사의 시리즈 B라운드의 일부였다.

그 시리즈 B 캐피탈은 다음세대 칩의 제조와 디자인하는 방법을 믿을 수 있고, 더 효율적으로 활성화하기 위해 Tela의 기술을 시장에서 사용하고 있다. Tela는 이 세부 전략과 기술을 공개 발표했다.

인텔 캐피탈의 관리자 Sean Doyle은 “반도체 제조 산업에서 새로운 크기조절 기술의 필요는 중요하다.”라고 말했다. Tela Innovations은 절연 프로세싱 기하학에서 일하는 회사들을 위한 제조와 반도체 디자인에 도전하는 어드레싱이다.

Tela의 CEO 겸 회장인 Scott Becker은 “우리는 인텔 캐피탈이 우리의 투자자가 된것에 대해 아주 기쁘게 생각한다. 인텔 캐피탈의 가치를 넘어서는 공평 접근법은 2008년에

시장에서 우리의 기술을 가져오는 것은 우리에게 유용하게 될 것이다.”라고 설명했다.

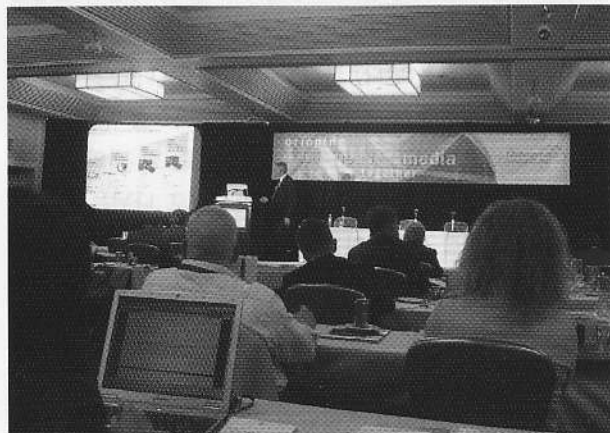
Tela는 반도체 프로세서의 지속적인 크기조절 방법의 기준에 접근하는 석판술과 최근 디자인의 제한을 명확하게 어드레스 한다. 이것은 석판술의 최적화된 레이아웃의 라우팅 결과와 종합적으로 다룰 때, 논리, 임베디드 메모리, 아날로그 및 I/O 기능을 사용하기 위해 미리 정의 된 물리적 토폴로지의 접근성을 사용한다.

### ZORAN, 가장 최신 DTV 기술 시연

**ZORAN** ZORAN은 모바일 멀티미디어 DTV 제품을 위한 컴팩트 참조 디자인의 최신 DTV 기술 설명을 발표했다. 곧 나올 USB와 HDMI, IPTV 그리고 모바일 멀티미디어 DTV 제품들을 위한 다른 어플리케이션 기술을 공개 한 것이다.

Full 1080p HDMI, USB connectivity를 포함한 통합 기술들 뿐 아니라 멀티미디어 특색 IPTV 특성도 포함되어 있다.

ZORAN은 전세계적인 시장을 위한 규격에 맞는 제품 제조 공급업자를 위한 다양한 복합 고해상 디지털 텔레비전 기술들을 제공한다. DTV 브랜드들은 Best Buy의 Insignia, Costco의 Scepter, Haier, Magnavox, Orion, Sanyo, TPV 그리고 K-Mart, 월마트 그리고 다른 주요 매장에서 팔리고 있는 모델, Xococo 등이 포함된다.



ZORAN은 또한 미국, 일본, 유럽 등의 국가에 있는 지역 기준지 제품 제조업체들과 중국, 인도 등의 국가들에 있는 다양한 신흥기준들을 위한 다양한 새로운 셋탑 박스 기술들을 제공한다.

ZORAN의 마케팅 부회장 Dave Pederson은 "ZORAN은 계속해서 전세계적인 신흥기준들, 고객 전자 산업을 위한 혁신적인 새로운 기술들을 제공할 것이다. 우리는 이미 새로운 세대의 모바일 TV방송 단말기와 같은 디지털 텔레비전 제품들을 선보였다. 앞으로 몇 년 후, 우리는 손에 드는 단말기로 IPTV의 발달을 볼 수 있을 것이며, 새로운 DTV 텔레비전들은 고객들의 TV시청 경험을 향상 시킬 것이다." 라고 설명했다.

### 3 LEAF SYSTEMS, 인텔프로세서와 X86 장을 위한 다음세대 가상화 기술로 라이선스 맺다

기업 데이터 센터를 위한 다음세대 가상화 솔루션 제공자인 3 LEAF SYSTEMS는, Intel Quick Path Interconnect와 라이선스 계약을 맺었다. 3 LEAF SYSTEMS는 성장중인 x86 서버 시장을 위한 가상화 솔루션 발전을 위해 Intel Quick Path 기술을 사용 할 것이다.

Intel Quick Path Interconnect 라이선스는 주문형 자원 서버를 할당하는 완전한 가상화 데이터 센터에서 제공하는 서버를 3 LEAF SYSTEMS에게 허락한다. 이 라이선스는 같은 시간에 두드러지게 비용을 줄이는 동안 비즈니스 요구에 충족하는 수요자원을 빠르고 효과적으로 할당하는 비즈니스를 허락하는 '동적 데이터 센터'를 활성화 할 수 있는 3 LEAF SYSTEMS의 전략적인 주요 이정표이다.

3 LEAF SYSTEMS의 CTO 이자 회장인 Bob Quinn은 "Intel Quick Path Interconnect에 부여되는 라이선스는 3 LEAF SYSTEMS의 가상화에 접근하는 자신 있는 선출방법이다. 또한 이는 서버 가상화 공간에 있는 3 LEAF SYSTEMS를 위한 잠재시장의 배경이 될 것이다."라고 말했다. 아주 낮은 잠재성과 아주 높은 대역폭을 가지고 있는 Intel Quick Path 기술은 우리의 가상화 NIC를 위한 이상적인 연결 점이다. Intel Quick Path Interconnect 지지와



함께, 3 LEAF SYSTEMS는 인텔 프로세서의 운용중인 서버를 포함하는 가 간섭성 네트워크를 확장시키며, 우리에게 x86 서버 시장을 100% 활용하도록 한다.

3 LEAF SYSTEMS는 전통적인 데이터 센터 작업에서 완전하게 가상화되는 환경으로 이동하고 있는 선두 기업이다. 3 LEAF SYSTEMS의 다음 세대 가상화 기술은 데이터 센터 자원을 최대한으로 활용하며, 극적으로 비용을 줄이는 동안 유동성과 메인 프레임 부류 확장성 있는 유용한 서버들을 제공한다.

3 LEAF SYSTEMS의 기술은 데이터 센터 내에서 I/O 자원과 메모리, 완전한 가상의 CPU의 집합 기업 솔루션을 제공하는데 있어서 특별하다. 이 확장성, 유연성, 그리고 데이터 센터 인프라를 동적 할당의 모든 서버 자원을 활성화 수요가, 이동 시간에 그들을 단지 응용 프로그램에서 패션에 따라서 리소스의 사용을 극대화하고 전력 소비를 최소화한다. 이러한 광대하며 간단하게 관리시켜주며, 이용에 대응하는 스파이크와 성공적인 관리 비즈니스를 허락한다. 그 결과, 데이터 센터 기반구조는 더 민첩해지며, 유동적이고 경영상의 자본비용이 극적으로 줄어들었다.

인텔의 기술 마케팅 관리자인 Lorie Wigle은 "Intel Quick Path Interconnect는 인텔기본 서버에 두드러지게 증가하는 성과를 제공하는 업계에게 허용할 것이다." 또한 "가상화 솔루션 선두 벤더 중 하나인 3 LEAF SYSTEMS의 Intel Quick Path 기술의 라이선스는 혁신 산업의 플랫폼인 Intel 아키텍처를 강화 시킨다. 그 기본원칙은 이제 동적 데이터 센터에 대한 위치에 메인 프레임 클래스를 조합하여 자원의 효율성과 가용성 및 안정성을 추구 할 것이다."라고 설명했다. **SM**